

2022年3月31日

会社名：株式会社ディスコ

代表者名：代表取締役社長 関家一馬

コード番号：6146 東証第一部

問い合わせ先：広報室（03-4590-1090）

（開示事項の経過）「羽田 R&D センター」を開設 研究開発機能を増強

半導体製造装置メーカー・株式会社ディスコ（本社：東京都大田区、社長：関家一馬）は、2021年12月6日に締結した不動産購入契約に基づき、本日、東京都大田区東糀谷の不動産（建物付土地）の取得を完了いたしました。

また2022年4月1日より当該不動産を「羽田 R&D センター」として使用開始いたします。これにより、研究開発（R&D）機能のさらなる強化を可能とし、今後の半導体・電子部品市場における高いニーズに対応いたします。

開設の目的

① 研究開発機能の増強

AI・IoT や次世代通信技術のさらなる普及、自動運転技術の進展、カーボンニュートラルへのニーズなどにより、中長期的な半導体・電子部品市場の拡大が見込まれます。そのため当社技術領域への需要と研究開発テーマが増加し、製品・技術開発拠点である本社・R&D センター（東京都大田区大森北）は既にフルキャパシティに近い状態にありました。羽田 R&D センターの開設で研究開発拠点全体のフロア面積は従来比で約 2.2 倍となり、多様な開発ニーズに柔軟に対応できる体制の構築が可能となります。

② 生産体制の強化

当社は、広島事業所・呉工場/桑畑工場（ともに広島県呉市）および長野事業所・茅野工場（長野県茅野市）を生産拠点とし、製品開発を主に本社・R&D センターにて行っています。このたびの羽田 R&D センターの開設により、これまで生産拠点で行っていた新製品の量産に向けた検証が開発拠点で実施可能となります。また、昨今のような高需要期には本社の従業員が広島・長野へ生産支援に多数赴きますが、今後は羽田のスペースを活かし在京のまま対応できるようになります。これらの実現で、さらに安定した製品生産体制の構築を図ります。

羽田 R&D センター概要

| | |
|--------|----------------------------------|
| 名称 | 株式会社ディスコ 羽田 R&D センター |
| 開設日 | 2022年4月1日 |
| 主な用途 | 精密加工装置、精密加工ツールおよび周辺製品・技術に関する研究開発 |
| 所在地 | 東京都大田区東糀谷六丁目 |
| 敷地面積 | 32,321.89 m ² |
| 建物 | 全 7 棟（最大階数棟は 11 階建） |
| 延床面積 | 63,008.53 m ² （7 棟計） |
| 不動産取得日 | 2022年3月31日 |
| 取得額 | 約 280 億円（全額自己資金※） |

※取得額は取得日時点における直前連結会計年度（2020 年度）末日の連結純資産の 30%未満であり、当該固定資産の取得による 2022 年 3 月期（2021 年度）通期業績に与える影響は軽微です。

(参考)既存の当社・R&D センター概要

| | |
|------|------------------------------------|
| 名称 | 株式会社ディスコ 本社・R&D センター |
| 所在地 | 東京都大田区大森北二丁目 13 番 11 号 |
| 敷地面積 | 11,570.54 m ² |
| 延床面積 | 52,760.27 m ² (A 棟+B 棟) |
| 竣工 | A 棟 2004 年 11 月 B 棟 2008 年 11 月 |

株式会社ディスコについて

当社は、半導体や電子部品の製造に使用されるダイシングソーやグラインダなどの精密加工装置、および装置に取り付けて使用する精密加工ツールを提供する「半導体製造装置メーカー」です。これら製品に加え、装置とツールの利用技術の提供によりお客様の最適な加工結果を追求してきた結果、国内外のデバイスメーカーおよび半導体受託製造企業などに広く、当社製品・加工技術が採用されています。

詳細については、ウェブサイト www.disco.co.jp をご覧ください。

お問い合わせ先

株式会社ディスコ 広報室 広報チーム

03-4590-1090